

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 21 d.

suderinimo su technikos pažanga tikslais iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedo nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4054)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/747/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ⁽¹⁾, ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

- (1) Pagal Direktyvą 2002/95/EB Komisija turi įvertinti tam tikras pavojingas medžiagas, uždraustas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį.
- (2) Tam tikroms medžiagoms ir komponentams, kuriuose yra švino ir kadmio, turėtų būti netaikomas (arba vis dar netaikomas) draudimas, kadangi šių pavojingų medžiagų naudojimas šiose specifinėse medžiagose ir komponentuose vis dar yra neišvengiamas.
- (3) Siekiant laipsniškai nutraukti pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje, kai kurių tam tikrų konkrečių medžiagų ar komponentų draudimo išimčių taikymo sritis turėtų būti ribota, jei šių medžiagų tokiose priemonėse bus galima nenaudoti.
- (4) Pagal Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 1 dalies c punktą kiekvieną priede nurodytą išimtį yra būtina persvarstyti bent kartą per ketverius metus arba po ketverių metų nuo įrašymo į sąrašą, siekiant išbraukti elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir komponentus iš sąrašo, jei jų eliminavimas ar pakeitimas pakeičiant konstrukciją ar medžiagas ar panaudojant sudėtinę dalis, kurioms nereikia jokių iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, yra techniškai ar moksliai įmanomas, jei dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis

aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai nenusveria jų naudą aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai.

- (5) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/95/EB.
- (6) Remiantis Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija konsultavosi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis ir pateikė savo pastabas 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų ⁽²⁾ 18 straipsniu įsteigtam komitetui (toliau – komitetas).
- (7) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/95/EB priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys

⁽¹⁾ OL L 37, 2003 2 13, p. 19. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2005/717/EB (OL L 271, 2005 10 15, p. 48).

⁽²⁾ OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

PRIEDAS

Direktyvos 2002/95/EB I priedas yra iš dalies keičiamas taip:

1) 7 dalis pakeičiama taip:

- „7. — Aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydmetaliuose, kuriuose švino yra 85 % masės arba daugiau) esantis švinas,
- serverių, laikmenų ir laikmenų masyvių sistemų, tinklų infrastruktūros perjungimo, signalų, perdavimo įrangos ir telekomunikacijų valdymo tinklo lydmetaliuose esantis švinas,
- elektroninėse keramikos dalyse (pvz., pjezoelektroniniuose įtaisuose) esantis švinas.“;

2) 8 dalis pakeičiama taip:

- „8. Kadmis ir jo junginiai elektriniuose kontaktuose bei plakiravimas kadmiu, išskyrus panaudojimą, uždraustą pagal Direktyvą 91/338/EEB (*), iš dalies keičiančią Direktyvą 76/769/EEB (**) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos ir naudojimo apribojimų.

(*) OL L 186, 1991 7 12, p. 59.

(**) OL L 262, 1976 9 27, p. 201.“;

3) pridedami šie punktai:

- „11. Švinas, naudojamas standartinių mikroschemų jungčių sistemose.
12. Švinas, naudojamas terminio laidumo modulio *c* formos žiedo dangoje.
13. Švinas ir kadmis optiniame ir filtravimo stikle.
14. Švinas lydmetaliuose, turinčiuose daugiau nei du elementus jungtims tarp kaiščių ir mikroprocesorių junginio, kuriuose švino yra daugiau nei 80 % ir mažiau nei 85 % masės.
15. Švinas lydmetaliuose, skirtuose palaikyti reikiamą elektros įtampą tarp puslaidininkio modulio ir laikančios plokštės, esančių „Flip Chip“ tipo mikroschemų junginiuose.“.
-